

請求の範囲

- [請求項1] 基板を搬送する搬送部と、
 前記搬送部によって搬送される前記基板の成膜領域に電解質膜を成膜する成膜部と、
 前記成膜部での成膜後に前記搬送部によって搬送される前記基板の前記電解質膜に接触して前記成膜領域に含まれる異物を除去する異物除去部と、を備える、
 成膜装置。
- [請求項2] 前記異物除去部による異物除去後に前記搬送部によって搬送される前記基板の前記成膜領域に、電解質膜を再成膜する再成膜部を備える、
 請求項1に記載の成膜装置。
- [請求項3] 前記異物除去部が前記基板に対して相対的に移動した状態で前記電解質膜に接触する接触部を有する、
 請求項1又は請求項2に記載の成膜装置。
- [請求項4] 前記接触部が発泡樹脂材料からなる、
 請求項3に記載の成膜装置。
- [請求項5] 前記接触部が不織布からなる、
 請求項3に記載の成膜装置。
- [請求項6] 前記接触部が円筒状のローラとされる、
 請求項3から請求項5のいずれか一項に記載の成膜装置。
- [請求項7] 前記ローラが前記基板の搬送方向と交差する方向の軸線を有する、
 請求項6に記載の成膜装置。
- [請求項8] 前記ローラが前記基板の前記搬送方向と逆方向に回転される、
 請求項7に記載の成膜装置。
- [請求項9] 前記ローラと前記基板とは、前記接触部の接触点において互いに接触し、
 前記ローラの回転方向に沿って前記接触点から見た前記ローラの接

線方向は、前記基板の前記搬送方向とは反対である、
請求項 7 に記載の成膜装置。